

深圳市龙图光罩股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：龙图光罩

证券代码：688721

编号：2026-004

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/>路演活动 <input checked="" type="checkbox"/>现场参观 <input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>华泰资产、中保投资、CPE 源峰、中信证券、建投华科投资、国海创新资管、申万菱信、申万宏源、广州越秀产投、上汽金控、广汽资本、江西国控、江西金控、南昌产投、殷实基金、温氏投资、广东邦领、湖南迪策、湖南瑞世、湖南轻盐、厦门恒兴、厦门百江、伟星资产、上海宝弘资产、创富兆业、纽富斯资管、宝创资本、尚融资本、东方嘉富、苏州明善、中纳资管、鼎峰明道、前海中船、万马控股、向三创、宁波和济</p>
<p>时间</p>	<p>2026年6月25日星期四 15:00</p>
<p>地点</p>	<p>珠海市龙图光罩科技有限公司</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>1、董事长：柯汉奇 2、董事会秘书兼财务总监：邓少华 3、证券事务代表：李建东</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、公司基本情况 深圳市龙图光罩股份有限公司成立于2010年，是具备关键技术攻关能力，拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商，主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。 自2024年8月公司完成科创板挂牌上市以来，公司不断增加投入进行技术攻关和产品迭代，半导体掩模版工艺能力从130nm逐步提升至65nm，并已完成40nm工艺节点的生产设备布局，产品广泛应用于信号链及电源管理IC等成熟制程，以及功率器件、MEMS传感器、先进封装等特色工艺制程。 公司于2022年8月设立珠海市龙图光罩科技有限公司，紧随国家半导体行业发展战略，围绕高端半导体芯片掩模版领域持续加大研发投入，逐步实现高端制程的国产化配套，成为国内一流、国际领先的半导体掩模版标杆企业。</p> <p>二、投资者互动交流</p>

1、40nm-28nm 半导体掩模版生产线项目规划如何？投资规模多大？

回复：公司 40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设项目（珠海二期）总投资为 195,436.81 万元，拟使用募集资金 146,000.00 万元，不足部分由公司自有或自筹资金解决。项目实施主体为公司全资子公司珠海市龙图光罩科技有限公司，建设地点位于珠海市，与现有珠海工厂位于同一厂区，但拥有相互独立的厂房和产线。建设周期为 36 个月。项目完全达产后，将新增 40nm-28nm 制程半导体掩模版年产能 15,000 片，产品主要面向高端模拟 IC、MCU 等下游应用场景，全面填补公司高端制程产能空白。除现有的二元掩模版和相移掩模版外，还将增加 KrF-PSM、ArF-PSM 以及 OMOG 掩模版等更高制程产品。

2、公司 40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设募投项目的进度如何？

回复：截至目前，公司 40nm-28nm 半导体掩模版生产线建设项目（珠海二期）的主体厂房已于 2025 年 9 月顺利封顶，目前处于洁净室装修施工与设备选型采购阶段；该项目环评已于 2026 年 4 月取得珠海市生态环境局批复，公司本次向特定对象发行股票事项亦已于 2026 年 4 月经股东会审议通过，目前已披露首轮问询回复。公司后续将结合募集资金到位情况，有序推进设备采购、安装调试及产线建设工作，并根据监管要求及时履行信息披露义务。

3、公司目前的制程升级节奏如何？会不会等现有产线开满，再布局更高阶工艺？

回复：公司半导体掩模版工艺能力已从 130nm 逐步提升至 65nm，并已完成 40nm 工艺节点的生产设备布局。当前，公司正全力推动珠海工厂 90nm 产品上量，实现 65nm/55nm 产品验证及小批量供货。

在制程升级节奏上，公司不会简单等待现有产线完全开满再布局更高阶工艺，而是采取“成熟制程持续优化、高端制程前瞻布局”的并行策略。一方面，公司通过深圳工厂和珠海一期持续巩固成熟制程的市场份额和盈利能力；另一方面，通过本次 40nm-28nm 募投项目的布局，抢占高端掩模版市场先机。这种梯次推进的策略既保证了公司当下的经营稳定性，也为未来的持续增长奠定了基础。

4、当前华为韬定律、先进封装发展等相关事件，是否带来光罩的大量需求？

回复：先进封装目前对于图形密度、堆叠结构及界面精度要求越来越高，RDL 层数变多、线宽更细、TSV/Hybrid Bonding 引入更多对准与图形化步骤，过程都需要掩模参与。但先进封装用掩模相比于半导体 IC 应用掩模，线宽要求不高，一般是微米或亚微米级，层数没有半导体 IC 复杂，目前我们和华天科技、通富微电、日月光等厂商都有合作，先进封装的发展对于公司来说亦是很重要的增量。

5、公司作为纯半导体第三方掩模版厂，第三方掩模版的长期市场渗透率、未来市场空间怎么判断？行业发展遵循什么规律？

回复：就境内半导体掩模版市场格局而言，第三方半导体掩模版市场占比预计在 50%左右，且国际厂商仍占据主导地位。长期来看，随着半导体行业专业化分工趋势的深化，第三方掩模版厂的市场份额有望不断增加。从市场空间来看，目前中国半导体掩模版国产化率较低，高端掩模版国产化率仅约 3%，国产替代空间广阔。

半导体掩模版行业的发展主要遵循以下规律：（1）技术驱动规律——掩模版精度需紧跟晶圆制程节点的演进，持续向更高端或先进制程迭代升级；（2）专业化分工规律——随着半导体产业分工日益细化，独立第三方掩模版厂商的角色愈发重要；（3）国产替代规律——在地缘政治和供应链安全背景下，掩模版自主可控成为国家战略需求，国内厂商面临历史性发展机遇；（4）规模效应规律——掩模版属于资本密集型行业，产能规模和产品结构决定企业的成本竞争力和盈利水平。

6、公司在人才体系和研发团队建设方面有何具体布局和优势？

回复：经过多年发展，公司已构建起“自主培养+高端引进+股权激励”三位一体的人才培养体系，形成了一支兼具稳定性与创新性的核心技术团队。在自主培养方面，公司核心研发、生产及管理骨干深耕光罩行业近二十年，深度参与公司技术研发与产品量产全流程，熟悉掩模版制造的各个核心环节，是公司技术传承与稳定发展的中坚力量。

在高端人才引进方面，公司积极从境内外光罩行业及晶圆制造头部企业吸纳具备高端制程研发经验的资深工程师，融合外部先进技术理念，有望加速公司未来在 40nm-28nm 领域的技术突破。在激励约束机制方面，公司上市前已实施三轮较大比例股权激励，核心团队持股比例高、绑定深；2026 年公司进一步推出上市后首期

	<p>限制性股票激励计划，覆盖核心技术人员及业务骨干，将团队利益与企业长远发展紧密结合。</p> <p>未来，公司将持续完善人才梯队建设，围绕高端产能建设需求加大人才引进力度，为技术持续升级提供坚实保障。</p> <p>7、问题：公司是否考虑向上游做战略投资或并购？</p> <p>回复：公司目前主要专注于主业，未来会根据发展需要，适时考虑向上游原材料、关键光刻工艺耗材等领域进行战略投资或并购，以增强供应链安全性和成本可控性。但当前阶段，公司仍将集中资源优先推进珠海二期 40nm-28nm 募投项目建设、现有一期产线产能爬坡及高端产品市场拓展，待主营业务效益稳定、盈利基础进一步夯实后，再择机考虑向上游延伸布局，以提升相关战略举措的成功率与确定性。</p> <p>8、问题：光掩模客户导入验证周期为什么这么长？具体流程是怎样的？</p> <p>回复：光罩完整导入平均周期约 12-18 个月，一般越高端节点，导入周期越长。客户认证导入常见分以下主要阶段：①设备标准匹配（量测等系列参数数据对齐）→②标准片制作验证（图形及指标是否匹配）→③随量产跑片，进行同工艺条件下的实测验证→④CP/WAT/FT 测试通过后正式 release。光掩模是「模具」，一旦问题会导致整批晶圆报废（损失可达数千万元），因此客户极其谨慎，所以认证导入周期偏长，一旦通过认证，客户不会轻易更换供应商，客户黏性较强。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 6 月 25 日星期四